

# Systemy klejenia okładzin ceramicznych i kamiennych

Przewodnik

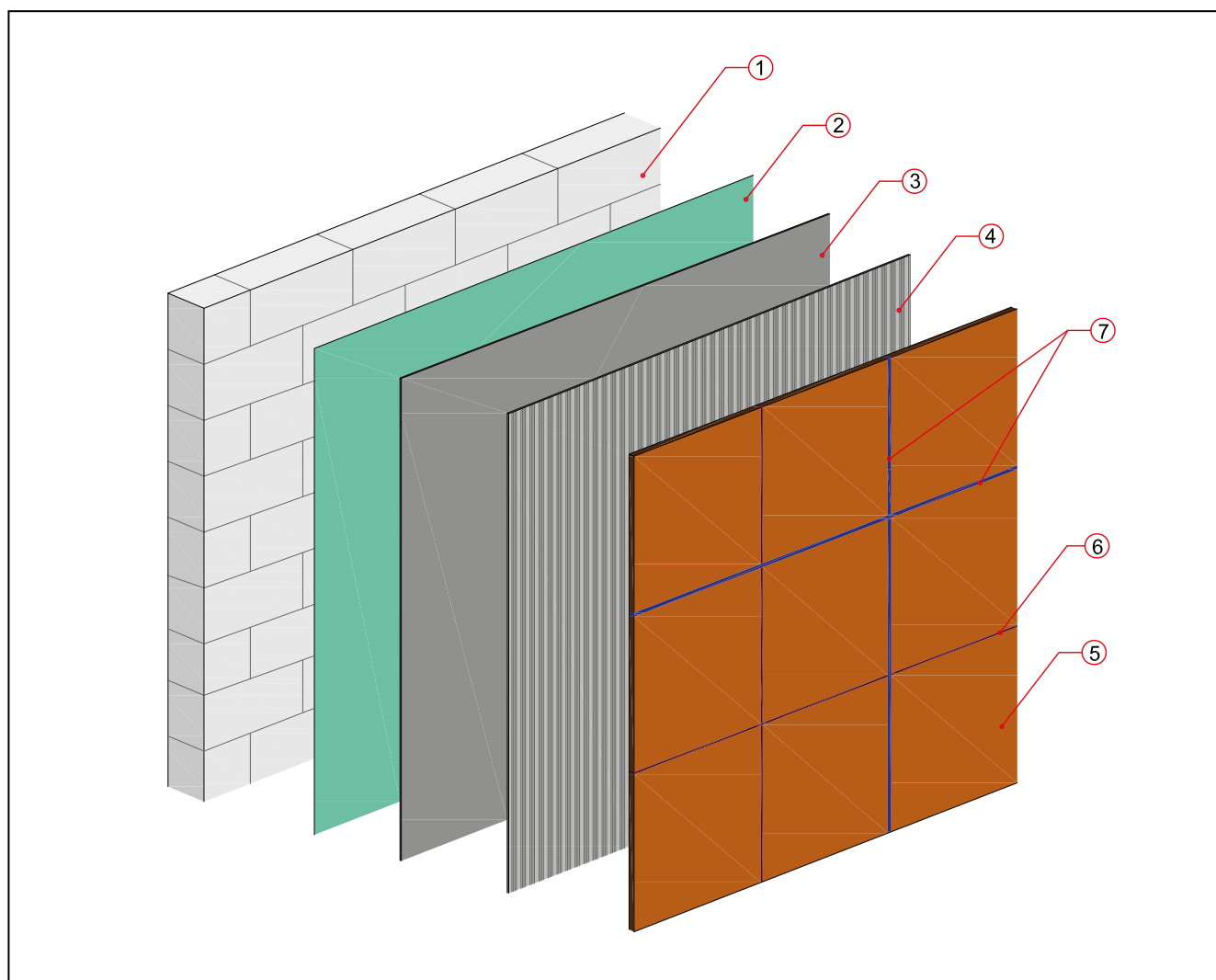


A brand of

**BASF**

We create chemistry

## 7. Płytki na fasadzie nieocieplonej



Nr	Elementy systemu	Produkt PCI	Opis produktu
1	Ściana murowana		
2	Grunt	PCI Gisogrund	Grunt dyspersyjny do podłoży chłonnych
3	Zaprawa wyrównująca ścianę	PCI Pericret	Szpachlówka cementowa
4	Klej do płytek	PCI Pericol Flex	Elastyczny klej cementowy do płytek
5	Płytki		
6	Fuga	PCI Nanofug	Elastyczna fuga cementowa
7	Uszczelniacz	PCI Elritan 100	1-składnikowy uszczelniacz poliuretanowy

### Opis obiektu - warunki eksploatacji - obciążenia

Okładziny płytkowe ceramiczne na fasadach nieocieplonych występują w różnych rodzajach budownictwa, zazwyczaj na obiektach o funkcji technicznej, nie wymagających ocieplania ścian. Ich obciążenie stanowią zmienne warunki pogodowe (temperatury, ssanie i parcie wiatru, opady deszczu, śniegu i gradu, cykle zamarzania i rozmrażania) i związane z tym procesy transportu ciepła i pary wodnej poprzez przegrodę ścienną. Powstające w wyniku tych zjawisk naprężenia mogą doprowadzić do pęknięć i odspojień w obrębie okładzin, co z kolei może skutkować upadkiem płytek z dużych wysokości i zagrażać zdrowiu, a nawet życiu przechodzących akurat w tym miejscu ludzi. Aby uniknąć takich sytuacji wymaga się, aby elewacja z okładziną ceramiczną wykonana została na podstawie indywidualnego projektu, precyzującego miejscowe szczegóły, np. rozmieszczenie dylatacji. Poniższy opis stanowi ogólną wytyczną i odnosi się do przedstawionego wyżej schematu.

## Podłoże

Zakłada się, iż podłożem jest mur z bloczków, cegły, pustaków itp. Podłoże winno być wystarczająco równe i nośne, a więc czyste, niezarysowane i pozbawione odspojień lub wykruszeń. Powinno ono też posiadać wymaganą przeciętną chłonność. W razie wątpliwości można ją poprawić stosując odpowiedni grunt, np. dyspersyjny środek **PCI Gisogrund**, rozcieńczony w odpowiednim stosunku wodą. Jeżeli dodatkowo potrzebne jest szpachlowanie wyrównawcze, umożliwiające już po kilku godzinach przyklejanie okładziny, zaleca się użycie do tego celu cementowej szpachlówki **PCI Pericret**. W okładzinie muszą być przejęte wszelkie dylatacje wykonane w podłożu.

## Wykonawstwo

### A. PRZYKLEJENIE PŁYTEK

Dopuszcza się przyklejanie płytek elewacyjnych klas  $AI_a$ ,  $AI_b$ ,  $AII_a$ ,  $BI_a$ ,  $BI_b$  lub  $BII_a$  wg normy PN-EN 14411 o grubości maks. 15 mm, dłuższym boku płytki maks. długości 40 cm, powierzchni pojedynczej płytki maks. 0,12 m<sup>2</sup> i masie powierzchniowej maks. 40 kg/m<sup>2</sup>. Do przyklejania należy użyć elastycznego kleju cementowego **PCI Pericol Flex** w metodzie kombinowanej. Minimalna grubość warstwy klejowej to 3 mm.

### D. SPOINOWANIE PŁYTEK

Spoinowanie najlepiej wykonać elastyczną cementową fugą: **PCI Nanofug**. Szerokość fug winna wynosić min. 3 mm i zależy od rozmiaru płytek. Udział spoin w ogólnej powierzchni okładziny nie powinien być mniejszy niż 6%.

Dylatacje o szerokości 10 mm, których rozmieszczenie i przekrój także określa projekt elewacji, należy wypełnić 1-składnikowym uszczelniaczem poliuretanowym **PCI Elritan 100**. Dylatacje poziome winny wypadać przynajmniej co kondygnację, pionowe zaś nie rzadziej niż co 6 m. Dylatowanie okładziny jest konieczne w narożach elewacji. Spoinę dylatacyjną należy ponadto przewidzieć na styku z innymi materiałami, np. stolarką lub ślusarką okienną i drzwiową.

## Uwagi

Wskazane rozwiązanie należy traktować jako przykładowe. Każdorazowo należy je adaptować do konkretnej konstrukcji i warunków eksploatacyjnych, opierając się zasadach wiedzy budowlanej. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z regionalnym Doradcą Technicznym PCI.